成都硅宝科技股份有限公司 关于拟对外投资暨设立硅宝(深圳)研发中心的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

- 1、成都硅宝科技股份有限公司(以下简称"公司")拟以自有资金人民币 1000万元在中国深圳设立研发中心,主要从事:有机硅材料、粘接密封材料、电 子元器件用包封灌封材料、电池材料、其它合成材料等新材料产品的开发、销售; 技术及信息开发、咨询、服务、转让: 试验评价: 检测技术服务: 货物及技术进 出口业务等。
- 2、公司于2019年9月24日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七 次会议, 审议并通过了《关于拟对外投资暨设立硅宝(深圳)研发中心的议案》。
 - 3、本次交易在董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。
- 4、本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

企业名称:成都硅宝科技股份有限公司

企业性质: 股份有限公司(上市)

注册地址:成都高新区新园大道16号

法定代表人: 王有治

注册资本: 330,901,951元

统一社会信用代码: 91510100713042497M

经营范围:生产(工业行业另设分支结构或另择经营场地经营)、销售化工产品(不含危险化学品)、建筑材料(不含危险化学品)、机电设备(不含汽车)、消防器材、安防产品;技术及信息开发、转让、咨询、服务;货物进出口、技术进出口(国家禁止的除外,国家限制的待取得许可后方可经营);设备安装、工程安装(凭资质许可证经营);环保工程、防腐保温工程(涉及资质许可证的凭相关资质许可证从事经营);质检技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

三、投资标的基本情况

- 1、公司名称: 硅宝(深圳)研发中心有限公司
- 2、公司类型:有限责任公司
- 3、注册地址:深圳市,具体地址待定
- 4、注册资本: 1000万元
- 5、出资方式:货币
- 6、经营范围:有机硅材料、粘接密封材料、电子元器件用包封灌封材料、 电池材料、其它合成材料等新材料产品的开发、销售;技术及信息开发、咨询、 服务、转让;试验评价;检测技术服务;货物及技术进出口业务(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
 - 7、经营期限:长期
- 8、企业法人治理结构:不设董事会和监事会。设执行董事一名,为法定代表人:设监事一名。执行董事、监事及主要经营负责人由公司委派。
 - 以上信息均以当地主管机关最终注册登记为准。

四、本次投资对公司的影响

公司拟在深圳设立研发中心,有利于公司及时获取前沿技术信息,紧贴市场需求,快速响应市场,顺应行业发展趋势。同时,有利于公司引进高端技术专业人才,提升公司研发能力,完善产品研发体系,增强公司核心竞争力。深圳研发中心的设立,将为公司整体业务的市场拓展提供新的发展平台,进一步保障公司可持续健康发展。



公司拟设立的深圳研发中心目前不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

五、本次对外投资可能存在的风险分析

- 1、研发中心的建设与管理涉及整合与调度公司层面的研发资源,执行初期可能存在一定的管理风险和市场风险。
- 2、研发中心设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准,具有不确定性。 敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第七次会议决议》;
- 2、《公司第五届监事会第七次会议决议》;
- 3、《公司独立董事对第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司 董事会 2019年09月24日

